****

**MSK PSA缩合型耐高温压敏胶 SG6470KH**

**·产品特性：**

SG6470KH有机硅缩合耐高温压敏胶是属于缩合型固化的一种有机硅压敏胶，耐温250-260℃下粘合性能良好,钢球初粘高，具有低迁移、粘性稳定、耐湿、耐热和耐候性强，移除无“鬼影”。涂层无气泡、透明度高，电气绝缘性特性很好的耐高温性能。

**·应用**

通用粘合剂:适用于 PI/PET 胶带制作

**·典型物性**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 单位 | 数值 |
| 外观 |  | 无色或淡黄色均匀液体 |
| 稀释剂 |  | 甲苯 |
| 固含量 |  | 60±2 |
| 粘度/25℃ | cp | 20,000~80,000 |
| 闭杯闪点 | ℃ | 2 |
| 钢板剥离力 | gf/in | 550-650 |
| 钢球初粘（30°） | # | 28-32 |

备注：1.以上是规格数据是（PI膜厚+胶厚）25umPI基材+25um干胶

2.（PET膜厚+胶厚）38umPET基材+25um干胶，剥离力900-1050gf/in

1. **建议配比**

SG6470KH: BPO粉末=100：2

**步骤 ：**

1.B.P.O除水处理

将B.P.O与甲苯按比例稀释（建议稀释到35%固含量）→ 搅拌溶解 → 过滤下层水分→ 用250目的滤网过滤杂质后备用（注意：确保B.P.O不含水分； B.P.O溶解提纯后，需在8小时内用完）。

2.底涂的调配

将底涂剂与催化剂D5000C按100:1添加，搅拌30~60min备用。

3.SG6470KH压敏胶水的调配

将SG6470KH与甲苯按一定比例稀释→搅拌溶解（20min）→添加绿色色浆→搅拌溶解（30min）→添加预处理好的B.P.O稀释液→搅拌均匀后过滤上机涂布。

**三、工艺**

1. 实验室涂布工艺：150℃ 2-3分钟烘烤即可。
2. 生产涂布参考工艺：烘箱温度设定为依此从80℃（胶水部分）→95℃（胶水部分）→135℃（胶水部分）→165℃（胶水部分）→155℃（胶水部分）→145℃（胶水部分），烘烤时间和温度是根据涂布量来调整，当涂布的干胶厚度在10um时，胶水的烘烤时间控制在1-1.5分钟之间，当涂布的干胶厚度在20um时，胶水的烘烤时间应控制在1.5分钟以上为宜。

以上内容是根据我们的经验提供，具体使用需要根据涂布工艺的特性决定。

声明：本产品说明书所提供信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识，我们力求准确，并相信具有很高的参考价值。但由于产品的使用通常在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改本说明书的权